UV TAPE

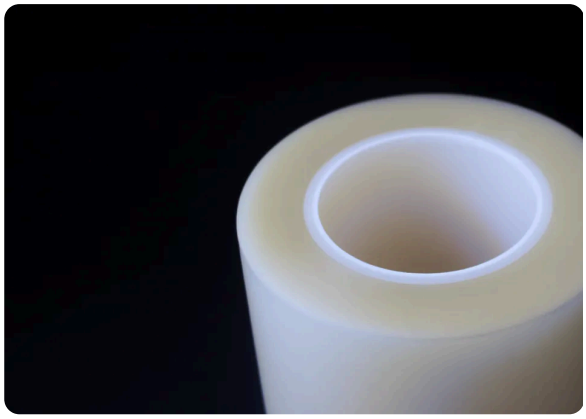
UV TAPE

UV 膠帶 · UV DICING TAPE

UV Dicing Tape · UV 膠帶

UV 膠帶（UV Tape）是晶圓切割用的承載膠帶：切割時黏住晶片、不脫落也不飛散，照射紫外線後黏性下降，取下不殘膠。佐和科技提供 PVC、PO、EVA、PET 多種基材的晶圓切割膠帶。

晶片切割及軟性電子零件之承載加工。加工結束後照射紫外線，即變成不沾黏，容易取下而不殘膠。



FEATURES

產品特點

高黏著 High adhesion

特殊黏膠配方，黏著力佳，切割時工作物不飛散。

不傷工件

降低對切割刀壽命的影響。

UV 反應時間快速 Fast UV curing

照射 UV 反應時間快速，有效提升工作效率。

不殘膠

照射紫外線後即變成不沾黏，容易取下而不殘膠。

SPECIFICATION

產品規格

用途 Application	切割（Dicing）、軟性電子零件承載加工
基材 Base film	PVC、PO、EVA、PET 多種基材
黏著力 Adhesive strength (before / after UV)	UV 前 3,000 ~ 35,000、UV 後 120 ~ 294 mN/25 mm，依型號（見下表）
拉伸強度 Tensile strength	22 ~ 35 N/10 mm，依型號（見下表）
UV 膠層厚度 Adhesive layer thickness	15 或 25 μm，依型號（見下表）
總厚度 Total thickness	95 ~ 213 μm，依型號（見下表）

各型號物性

Properties by model

型號 Model	基材（μm） Base film	UV 膠層厚度（μm） Adhesive layer	總厚度（μm） Total thickness	黏著力 UV 前 Before UV (mN/25 mm)	黏著力 UV 後 After UV (mN/25 mm)	拉伸強度 MD / CD Tensile strength (N/10 mm)
型號 A	PVC 80	15	95	3,200	230	27 / 24
型號 B（防靜電）	PVC 80	15	95	3,000	140	27 / 24
型號 C	PO 150	15	165	19,600	196	23 / 22
型號 D	PO 150	25	175	24,500	294	23 / 22

型號 Model	基材（μm） Base film	UV 膠層厚度（μm） Adhesive layer	總厚度（μm） Total thickness	黏著力 UV 前 Before UV (mN/25 mm)	黏著力 UV 後 After UV (mN/25 mm)	拉伸強度 MD / CD Tensile strength (N/10 mm)
型號 E	EVA 150	15	165	16,000	120	28 / 27
型號 F（防靜電）	PO 150	15	165	13,000	150	23 / 22
型號 G	PO 150	15	165	27,000	220	35 / 30
型號 H	PET 100	25	125	30,000	150	依型號，洽詢
型號 I	PET 188	25	213	35,000	150	依型號，洽詢

以上為測量值，並非保證值。黏著力依 JIS Z 0237 測試：剝離速度 300 mm/min、剝離角度 180°，被黏著體為 Si 鏡面（型號 H、I 為鈉玻璃），貼附 1 小時後測量；UV 照射條件 300 mJ/cm²、365 nm。拉伸強度為斷裂時的強度。

規格名詞說明

- **黏著力（Adhesive Strength）**：把膠帶從 wafer 表面剝離所需要的力，分成 UV 照射前與照射後兩個數值。
  - 照射前：切割時要有足夠的黏著力固定晶片，不脫落、不飛散。
  - 照射後：照射紫外線後變成不沾黏，容易取下，不殘膠。
- **拉伸強度（Tensile Strength）**：UV 膠帶抵抗永久變形和破壞的能力，數值越大越好。
- **UV 膠層厚度（Adhesive Layer）**：厚度越高，膠層吸震能力越好，可避免切割刀下刀時吸震力不足而造成切割位移。

需要完整規格書或其他型號，請來信或來電洽詢。

APPLICATIONS

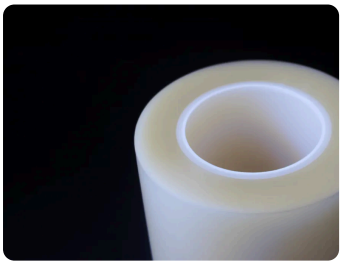
應用

LED　半導體　切割 Dicing　軟性電子零件承載加工

塗佈特殊黏膠，具高黏著力，使晶片在切割過程中不脫落、不飛散。

PHOTOS

產品照片



單捲



兩捲